

Title (en)

Electroplating plant, electrode and support system therefor and electroplating process

Title (de)

Elektroplattierungsanlage, Elektrode und Gegenhalter dafür und Elektroplattierungsverfahren

Title (fr)

Installation d'électrodéposition, électrode et organe d'appui pour cette installation et procédé d'électrodéposition

Publication

EP 0922791 A1 19990616 (FR)

Application

EP 98402805 A 19981113

Priority

FR 9715179 A 19971203

Abstract (en)

The support surface (6B) of the support component has grooves (7) emerging in the plating bath. A support component (2) for feeding current to the electrodes in an electroplating process has a support surface (6B), sliding and in electrical contact with the electrodes (3). The support surface (6B) of the support component has grooves (7) emerging in the plating bath. Independent claims are also included for : the utilization of this support component, the electrode incorporating this component, the electroplating installation using the electrode and the associated electroplating process.

Abstract (fr)

Installation d'électrodéposition d'un revêtement sur la surface conductrice d'une pièce comprenant des électrodes (3) immergées dans un bain reposant sur un organe d'appui (2, 4) servant à la fois de support et d'amenée de courant et présentant, avec les électrodes (3), une interface (6) d'appui comportant des rainures (7) débouchant dans le bain. Organe d'appui (2, 4) et électrodes (3) pour cette installation. On diminue sensiblement les pertes électriques et on améliore la durée de vie, notamment des organes d'appui. <IMAGE> <IMAGE>

IPC 1-7

C25D 17/00; **C25D 7/06**

IPC 8 full level

C25D 17/10 (2006.01); **C25D 7/06** (2006.01); **C25D 17/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C25D 7/0635 (2013.01 - EP US); **C25D 17/005** (2013.01 - EP US); **C25D 17/06** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] EP 0140474 A1 19850508 - KAWASAKI STEEL CO [JP]
- [A] EP 0052384 A1 19820526 - METALLGESELLSCHAFT AG [DE]

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

DOCDB simple family (publication)

US 6129820 A 20001010; AT E233835 T1 20030315; DE 69811836 D1 20030410; DE 69811836 T2 20040519; EP 0922791 A1 19990616; EP 0922791 B1 20030305; ES 2192313 T3 20031001; FR 2771757 A1 19990604; FR 2771757 B1 19991231; JP H11229197 A 19990824; US 6334943 B1 20020101

DOCDB simple family (application)

US 20454598 A 19981203; AT 98402805 T 19981113; DE 69811836 T 19981113; EP 98402805 A 19981113; ES 98402805 T 19981113; FR 9715179 A 19971203; JP 34443498 A 19981203; US 63702600 A 20000814